

南安市科学技术局随机抽查记录表

项目名称	高性能相控阵芯片空腔封装技术产业化		
项目实施单位	福建芯通科技有限公司		
项目编号	2024CT007		
项目总投资（万元）	392.7	项目扶持金额（万元）	100
项目进展情况	该项目为泉州市引进高层次人才团队，目前项目进展顺利，按合同约定开展研发工作。		
项目经费使用情况	经查阅企业提供的资金支出明细表及经费材料，经费使用符合项目合同约定。		
检查人员	黄书海 郑晓星 林一鸣		
日期	2026.6.29.		